

CEI 60749-20
(Première édition – 2002)

**DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS –
MÉTHODES D'ESSAIS MÉCANIQUES
ET CLIMATIQUES –**

**Partie 20: Résistance des CMS à boîtier
plastique à l'effet combiné de l'humidité
et de la chaleur de soudage**

IEC 60749-20
(First edition – 2002)

**SEMICONDUCTOR DEVICES –
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS –**

**Part 20: Resistance of plastic-encapsulated
SMDs to the combined effect of moisture
and soldering heat**

CORRIGENDUM 1

Page 6

Au lieu de:

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2012.

lire:

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.

Page 7

Instead of:

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2012.

read:

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2007.